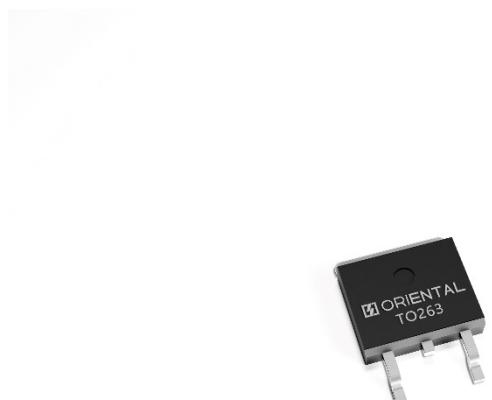




TO263

1、封装结构：

TO263 封装，通常包含 2 个主要引脚（如漏极、源极）和 1 个辅助引脚（如栅极），部分型号可能有更多引脚配置。其特点是采用表面贴装设计，底部有较大的散热焊盘，可通过 PCB 实现散热，适用于高功率应用场景。



2、尺寸与散热性能：

封装尺寸较大，相比 TO252 等封装，能提供更好的散热能力，适合处理较高功率的电流和电压。



3、应用场景：

常用于工业电源、电动汽车控制、高功率电机驱动、太阳能逆变器、服务器电源等对功率和散热要求较高的领域。